

平成 23 年 5 月 13 日

各 位

上場会社名 株式会社 アバールデータ
 代表者名 代表取締役社長 嶋 村 清
 (コード番号 6 9 1 8)
 問合せ先責任者 管理本部部長 大関 拓夫
 (TEL 042-732-1000)

平成 23 年 3 月期業績予想値と実績値との差異及び配当予想の修正に関するお知らせ

平成 22 年 9 月 14 日に公表しました平成 23 年 3 月期(平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日) の通期業績予想値と本日公表の実績値との差異及びこれに伴う配当予想の修正についてお知らせいたします。

記

1. 業績予想数値と実績値との差異(平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日)

(1) 連結

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	当 期 純 利 益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想 (A)	7,100	585	650	440	59.39
実績値 (B)	7,047	624	697	496	68.06
増減額 (B－A)	△52	39	47	56	－
増 減 率 (%)	△0.7%	6.7%	7.3%	12.8%	－
(ご参考)前期実績 (平成22年3月期)	4,470	△183	△40	45	6.07

(2) 個別

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	当 期 純 利 益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想 (A)	4,900	485	560	410	55.34
実績値 (B)	4,929	512	589	451	61.92
増減額 (B－A)	29	27	29	41	－
増 減 率 (%)	0.6%	5.6%	5.4%	10.1%	－
(ご参考)前期実績 (平成22年3月期)	2,667	△205	△88	31	4.11

差異が生じた理由

(1) 連結

半導体製造装置業界においては、昨年度末より大手半導体メーカーの設備投資が再開され、半導体関連市況は昨年に比べ大幅に回復をしております。また今期第 2 四半期以降は、産業機器及び各種検査機器全般における受注の回復により自社製品も堅調に推移しており、通期売上高は、ほぼ前回の予想数値どおり推移いたしました。また営業利益、経常利益及び当期利益につきましては、半導体製造装置関連受託製品売上高の増加による生産稼働率の向上及び付加価値の高い自

社製品売上高の増加により売上総利益が改善されたため前回の予想数値を上回りました。

(2) 個別

連結における差異が生じた同様の理由により、個別においても差異が生じております。

2. 配当予想の修正について

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期 末	合 計
前回予想 (平成22年9月14日発表)	円 銭 —	円 銭 8. 0 0	円 銭 —	円 銭 1 0. 0 0	円 銭 1 8. 0 0
今回修正予想	—	8. 0 0	—	1 2. 0 0	2 0. 0 0
当期実績	—	8. 0 0	—	—	—
前期(平成22年3月期)実績	—	0. 0 0	—	8. 0 0	8. 0 0

修正理由

当社は株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要施策の一つと考え、各期の連結業績に応じた利益の配分を基本方針としております。そして将来の企業価値向上に向けた事業投資に伴う中長期的な資金需要や財務状況の見通しなどを総合的に勘案し、連結配当性向を30%に高めるべく配当性向の向上を目指して株主の皆様への成果配分を行ってまいりました。

このような方針のもと、期末の配当予想につきましては、今回の業績発表に伴い上記のとおりいたします。なお平成23年2月24日にて大阪証券取引所のJ-NET市場において自己株式を1,554,300株(発行済株式数比率19.27%)取得したため、年間の連結配当性向は29.4%となります。

なお、本件につきましては、平成23年6月24日に開催を予定しております第52期定時株主総会のご承認を経て、実施することとなります。

以 上